

Rahmenspezifikation:

**Leiterplatten mit Leiterbildern auf einer oder auf
beiden Seiten ohne metallisierte Löcher**
Deutsche Fassung EN 123100 : 1992

DIN
EN 123100

Der Text dieser Norm umfaßt den Text des Harmonisierungsdokumentes

CECC 123100**Sectional Specification:**

Single and double sided printed boards with plain holes;
German version EN 123100 : 1992

Spécification Intermédiaire:

Cartes imprimées simples et doubles faces à trous non métallisés;
Version allemande EN 123100 : 1992

Die Europäische Norm EN 123100 : 1992 hat den Status einer Deutschen Norm.**Nationales Vorwort**

Zuständig für diese Europäische Norm ist in Deutschland das Komitee 661 "Gedruckte Schaltungen" der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE), von dem die Übersetzung zur Veröffentlichung autorisiert wurde.

Zu den in dieser Norm zitierten IEC-Publikationen bestehen folgende DIN-Normen und andere Veröffentlichungen:

IEC 68	siehe Normen der Reihe DIN IEC 68
IEC 194	siehe DIN IEC 194
IEC 249	siehe Normen der Reihe DIN IEC 249
IEC 326-2	siehe DIN IEC 326 Teil 2
IEC 326-3	siehe DIN IEC 326 Teil 3
IEC 326-4	siehe DIN IEC 326 Teil 4
CECC 23000	siehe DIN EN 123000

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:

Siehe Abschnitt 1.2

— in nationalen Zusätzen:

Normen der Reihe

DIN IEC 68	Elektrotechnik; Grundlegende Umweltprüfverfahren
DIN IEC 194	Gedruckte Schaltungen; Begriffe; Identisch mit IEC 194 : 1988

Normen der Reihe

DIN IEC 249	Basismaterialien für gedruckte Schaltungen; Prüfverfahren
DIN IEC 326 Teil 2	Gedruckte Schaltungen; Leiterplatten; Teil 2: Prüfverfahren; Identisch mit IEC 326-2 : 1990
DIN IEC 326 Teil 3	Gedruckte Schaltungen; Leiterplatten; Teil 3: Gestaltung und Anwendung von Leiterplatten
DIN IEC 326 Teil 4	Gedruckte Schaltungen; Leiterplatten; Teil 4: Anforderungen an Leiterplatten mit Leiterbildern auf einer oder auf beiden Seiten und ohne metallisierte Löcher
DIN EN 123000	Fachgrundspezifikation: Leiterplatten; Deutsche Fassung EN 123000 : 1991

Fortsetzung 1 Seite EN-Norm
und 22 Seiten CECC-Dokument

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)



Documents

Document Sharing Hub

UDC:

Deskriptoren: Qualität, elektronische Bauelemente, Leiterplatten

Deutsche Fassung

Rahmenspezifikation:

**Leiterplatten mit Leiterbildern auf einer oder auf beiden Seiten
ohne metallisierte Löcher**

**Sectional Specification:
Single and double sided printed
boards with plain holes**

**Spécification Intermédiaire:
Cartes imprimées simples et
doubles faces à trous non
métallisés**

Diese Europäische Norm wurde vom CENELEC Komitee für Bauelemente der Elektronik (CECC) am 12. Dezember 1991 angenommen. Der Text dieser Norm umfaßt den Text der CECC 23 100 Ausgabe 1 1985 der zugehörigen CECC Spezifikation. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die Forderungen der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CECC Generalsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm existiert in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in die Landessprache gemacht und dem CECC-Generalsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich. Mit Ausnahme der nationalen elektrotechnischen Komitees von Griechenland, Island und Luxemburg sind die Mitgliedsländer des CECC mit denen von CENELEC identisch.

CECC

CENELEC Komitee für Bauelemente der Elektronik

CENELEC Electronic Components Committee

Comité des Composants Electroniques du CENELEC

Generalsekretariat: Gartenstr. 179, D- 6000 Frankfurt/Main 70

Système Harmonisé d'Assurance de la Qualité
des Composants Electroniques

SPECIFICATION INTERMEDIAIRE:

**CARTES IMPRIMEES
SIMPLE ET DOUBLE FACE
SANS TROUS METALLISES**

Harmonized System of Quality Assessment for
Electronic Components

SECTIONAL SPECIFICATION:

**SINGLE AND DOUBLE SIDED
PRINTED BOARDS WITH
PLAIN HOLES**

Harmonisiertes Gütebestätigungssystem für
Bauelemente der Elektronik

RAHMENSPEZIFIKATION:

**LEITERPLATTEN MIT LEITER-
BILDERN AUF EINER ODER
AUF BEIDEN SEITEN OHNE
METALLISIERTE LÖCHER**



1

Edition
Issue
Ausgabe

CECC 23100

INHALT

	Seite
VORBEMERKUNG	2
VORWORT	2

Abschnitt

1	Einführung	3
1.1	Geltungsbereich und Zweck	3
1.2	Bezugsdokumente	3
2	Allgemeines	4
3	Prüflinge	4
3.1	Befähigungsprüfprogramm	4
3.2	Gütebestätigungskontrollen	5
4	Einzelbestimmung	5
5	Leiterplattenmerkmale	5
	Tabelle I	6
	Tabelle II	11
6	Befähigungsprüfprogramm	13
7	Gütebestätigungskontrollen	15
8	Prüfbilder	18
8.1	Anwendung von Prüfbildern und Prüfplatten	18
8.2	Kombiniertes Prüfbild (CTP)	19
8.3	Mehrfachanordnungen des CTP	20
	Bild 2: Kombiniertes Prüfbild	21

VORBEMERKUNG

Das CENELEC-Komitee für Bauelemente der Elektronik (CECC) besteht aus den Mitgliedsländern des Europäischen Komitees für Elektrotechnische Normung (CENELEC), die sich an einem harmonisierten Gütebestätigungssystem für elektronische Bauelemente beteiligen wollen.

Ziel des Systems ist es, den internationalen Handel zu erleichtern durch Harmonisierung der Normen und Gütebestätigungsverfahren für elektronische Bauelemente und durch die Erteilung eines international anerkannten Konformitätszeichens oder einer Konformitätsbescheinigung. Die entsprechend den Festlegungen dieses Systems hergestellten Bauelemente werden deshalb in allen Mitgliedsländern ohne weitere Prüfung anerkannt.

Die vorliegende Spezifikation ist vom CECC angenommen worden. Sie wurde für diejenigen Länder erarbeitet, die am System teilnehmen und harmonisierte nationale Rahmenspezifikationen für LEITERPLATTEN MIT LEITERBILDERN AUF EINER ODER AUF BEIDEN SEITEN OHNE METALLISIERTE LÖCHER herausgeben wollen. Sie ist in Verbindung mit den zur Zeit gültigen Bestimmungen des CECC-Systems zu verstehen.

Zur Zeit der Herausgabe dieser Spezifikation sind folgende Länder Mitglied des CECC: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz und Spanien. Diese Spezifikation kann unter den auf dem blauen Deckblatt befindlichen Anschriften bezogen werden.

EINLEITUNG

Diese Spezifikation wurde von der WG 23: "Gedruckte Schaltungen" des CECC erstellt.

Sie basiert auf den Publikationen der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC).

Der Text dieser Spezifikation wurde dem CECC mit den unten aufgeführten Schriftstücken zur Abstimmung vorgelegt und vom Präsidenten des CECC zur Herausgabe als CECC-Spezifikation freigegeben.

Schriftstücke

CECC(Sekretariat)1052/1052A
CECC(Sekretariat)1547

Abstimmdatum

November 1981
August 1984

Abstimmbericht

CECC(Sekretariat)1250
CECC(Sekretariat)1621

ANMERKUNG DES SEKRETARIATS:

DA DIESE SPEZIFIKATION VON DER INDUSTRIE DRINGEND BENÖTIGT WIRD, HAT DER PRÄSIDENT DES CECC ENTSCIEDEN, DIESE SPEZIFIKATION ZU VERÖFFENTLICHEN, OHNE DASS SIE DAS VOLLE EDITORIALE VERFAHREN DURCHLAUFEN HAT. BENUTZER DIESER SPEZIFIKATION WERDEN GEBETEN, DARIN ENTDECKTE FEHLER DEM GENERALSEKRETARIAT DES CECC MITZUTEILEN, SO DASS ENTSPRECHENDE ÄNDERUNGEN Vorgenommen werden können.

Der Text wird zunächst in Deutsch und Englisch veröffentlicht. Die französische Fassung folgt, sobald sie fertiggestellt ist.

1. Einführung

IEC 326-4 ist die IEC-Norm für Leiterplatten mit Leiterbildern auf einer oder auf beiden Seiten ohne metallisierte Löcher. Die folgende Spezifikation enthält diese IEC-Norm und in Übereinstimmung mit der Fachgrundspezifikation CECC 23 000 die Angaben, die zusätzlich für Leiterplatten notwendig sind, die unter dem CENELEC System für gütebestätigte Bauelemente der Elektronik behandelt werden sollen.

1.1 Geltungsbereich und Zweck

Dies ist eine Rahmenspezifikation. Sie gilt für Leiterplatten mit Leiterbildern auf einer oder auf beiden Seiten ohne metallisierte Löcher, unabhängig davon, nach welchen Verfahren sie hergestellt wurden. Sie legt die zu bewertenden Merkmale sowie die für die Befähigungs-Prüfung und die Gütebestätigungskontrolle (losweise und periodische Prüfungen) anzuwendenden Prüfverfahren fest.

1.2 Bezugsdokumente

- | | |
|-------------|--|
| IEC 68 | - Basic environmental testing procedures |
| IEC 194 | - Terms and definitions for printed circuits |
| IEC 249 | - Metal-clad base materials for printed circuits |
| IEC 321 | - Guidance for the design and use of components intended for mounting on printed boards. |
| | |
| IEC 326-2 | - Printed boards - test methods |
| IEC 326-3 | - Design and use of printed boards |
| IEC 326-4 | - Specification for single and double sided printed boards with plain holes |
| CECC 00 010 | - Leiterplatten-Prüfverfahren |
| | |
| CECC 23 000 | - Fachgrundspezifikation für gütebestätigte Leiterplatten |